

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供融资担保额度的议案》；于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2024年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关于公司增加2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司2024年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。

一、对外担保的进展情况

近日，公司作为保证人，与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司苏州市华扬电子有限公司（以下简称“华扬电子”）向中信银行融资2,500.00万元提供连带责任保证担保。

二、合同主要内容

- 1、债权人：中信银行；
- 2、担保金额：2,500.00万元；
- 3、担保方式：连带责任保证；
- 4、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于

诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用;

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

三、累计对外担保情况

截止本公告披露之日,公司承担担保责任的对外担保总额为人民币285,251.62万元,占公司2023年度经审计净资产的224.14%,公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

四、备查文件

1、公司与中信银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年2月25日